

证券代码：603203

证券简称：快克智能



快克智能装备股份有限公司

2025 年年度股东大会

会议资料

二〇二六年五月

目录

快克智能装备股份有限公司 2025 年年度股东大会参会须知	10
快克智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	11
议案一： 关于 2025 年度董事会工作报告的议案	13
议案二： 关于 2025 年度报告及摘要的议案	22
议案三： 关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	23
议案四： 关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	28
议案五： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 审计机构的议案	29
议案六： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	30
议案七： 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案	31
议案八： 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	32
议案九： 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案	33
议案十： 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	34
议案十一： 关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案	35
议案十二： 听取 2025 年度独立董事述职报告	37

快克智能装备股份有限公司

2025 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快克智能关于召开 2025 年年度股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计（计票、监票），由两名股东代表与见证律师共同负责，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

快克智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00
- (二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	董事会秘书
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	
5.2	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	
5.3	《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	
5.4	《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	
5.5	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	
5.6	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	
5.7	《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》	
5.8	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	
5.9	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	
5.10	《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	
5.11	《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	
5.12	听取《公司独立董事2025年度述职报告》	

6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案一： 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事会工作报告如下：

一、 经营情况讨论与分析

公司持续深耕精密电子组装和半导体封装领域，聚焦 AI 物理终端智能穿戴、光通信与数据中心、半导体先进封装、汽车电动化及智驾等核心赛道，持续突破关键核心技术，经营质量稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 108,050.09 万元，同比增长 14.33%；归母净利润 13,839.22 万元，同比减少 34.78%；扣非归母净利润 12,777.01 万元，同比减少 26.77%。

基于 2025 年度税收自查，公司补缴了 2024 及以前年度企业所得税，若剔除补税款及股份支付费用的影响，归母净利润 22,171.94 万元；扣非归母净利润 21,109.73 万元，同比增长 21.00%。

（一）精密焊接装联设备：AI 全场景需求爆发驱动高端市场持续渗透

2025 年，AI 技术在数据中心、消费电子、汽车电子等领域的深度渗透，带动精密焊接工艺需求持续升级，行业呈现多赛道同步增长的格局。

AI 数据中心建设提速, AI 服务器与高速光模块拉动精密焊接装联需求增长。据 IDC 数据，2025 年全球 AI 服务器市场规模达 3,660 亿美元，同比增长 44.6%，全年出货量达 180 万台，带动高速连接器市场规模超 90 亿元，2024-2028 年全球有源铜缆（AECs）市场复合增长率达 45%；据高盛预测，2025-2028 年全球光模块市场规模由 230 亿美元增至 447 亿美元，年复合增速约 22%，800G 及以上高端产品 2025-2027 年复合增速高达 87%，进入规模化量产周期。高速连接器与光模块的制造工序对焊接装联的精度、一致性与可靠性提出严苛要求，市场需求快速扩容。报告期内，公司焊接、点胶、激光打码等设备已进入富士康、安费诺、莫仕等全球头部企业，同时为多家光模块龙头企业批量供应精密焊接装联设备，相关订单持续放量，在 AI 数据中心赛道实现深度布局。

消费电子 AI 化浪潮全面加速，硬件终端智能化迭代节奏显著加快。据 Canalys 数据，2025 年全球 AI 手机渗透率达 34%；IDC 报告显示，全球可穿戴设

备出货量同比增长 10.5%，其中智能眼镜市场 AI 产品占比达 78%。随着 AI 技术深度融入，消费电子产品中柔性电路、微型传感器等精密组件应用场景持续拓宽，对焊接工艺的精细化、稳定性与一致性要求进一步提高。报告期内，公司针对 AI 终端开发的震镜激光焊设备，凭借高速高效的技术优势，持续稳定服务于 Meta 智能眼镜批量生产场景；依托激光热压、激光锡环焊等核心工艺，持续深化与小米等头部企业的合作。同时，公司 PCB 激光分板技术实现规模化落地，相关设备已在鹏鼎控股、立讯精密等行业龙头企业实现批量应用，形成稳定订单贡献。

汽车电动化与智能化深化，车载激光雷达与高压电驱系统带动精密焊接需求稳步增长。2025 年新能源汽车智能化进程持续深化，激光雷达加速普及，据 GGII 数据，2025 年中国乘用车激光雷达搭载交付量达 215.6 万颗，同比增长 83.14%，其中固态激光雷达出货量占比达 65%，对精密焊接工艺的稳定性与一致性提出更高要求。同时，新能源汽车高压快充趋势持续演进，800V 及以上高压平台加速普及，电驱控制器、车载充电机（OBC）等核心部件对高可靠焊接需求显著提升。公司作为电子组装精密焊接单项冠军，设备覆盖热压焊、激光焊、选择性波峰焊等全品类，进入博世汽车电子、比亚迪等头部企业产线，在核心部件生产中实现批量应用，为业务稳健增长提供支撑。

（二）机器视觉制程设备：全场景检测能力持续升级，多领域实现规模化突破

2025 年全球机器视觉市场稳步增长，据 GGII 数据，中国市场规模突破 210 亿元，同比增速超 14%；预计 2028 年将超 385 亿元，2024-2028 年复合增长率约 20%。AI 算力爆发与 AI 数据中心建设提速，推动光模块行业高速迭代、量价齐升，成为机器视觉检测最具弹性的增量赛道。高速光模块在芯片贴装、金线键合、光路对准、CPO 光电共封等环节对检测精度与稳定性提出严苛要求，直接拉动专用 AOI 检测设备需求快速扩容。报告期内，公司聚焦各领域检测需求，持续推动产品技术迭代与多场景落地应用，技术与业务协同推进：

在 SMT 领域，AI 服务器需求爆发带动 SMT/PCBA 产业增长，为视觉检测设备打开新的增长空间。据海关统计，2025 年中国大陆 SMT 自动贴片机进口量同比增长 11.41%，作为 SMT 产线核心标准设备的 AOI&SPI 需求同步提升。公司 SPI 及 2D/3D AOI 设备支持产线不停线 AI 训练，可在线优化工艺参数、提升产品直通率，实现批量出货。

在智能终端与穿戴全检领域，公司多维度全检设备批量应用于手机、笔记本、智能穿戴等产品，通过多相机协同成像，有效解决弧面、曲面、高低落差等复杂结构的全维度检测难题，检测覆盖率与精度持续提升；针对高密度微孔焊接 AOI 场景，公司在全球消费电子头部企业长期保持较高市场占有率。

在 AI 服务器领域，公司针对高速连接器外观检测的高要求场景，推出六面检 AOI 设备，可精准识别针脚变形、表面瑕疵等微米级缺陷，已在安费诺等行业头部客户实现批量交货。

在光模块领域，适配 800G 及以上高速光模块生产检测需求，公司开发的光模块专用 AOI 检测设备可精准识别激光器芯片偏移，金线键合缺陷，光芯片波导亚微米级缺陷等质量问题，正在市场积极推广。

在半导体封装检测领域，采用大理石平台打造高稳定检测基础，搭配双相机高低倍互补视觉模组精准捕捉各类细微缺陷，配套专属 AI 算法可自动识别检测特征、智能判定缺陷，大幅提升检测效率与准确率，全面适配半导体封装全流程高精度检测需求。

（三）智能制造成套装备：全球化交付能力持续提升，新兴场景拓展成效显著

2025 年，全球新能源汽车产业持续向电动化、智能化转型，线控底盘、高阶智驾域控制器、新能源热管理系统等核心部件技术迭代加速，单车自动化产线价值量与复杂度持续提升；同时 AI 服务器市场爆发带动液冷散热等配套基础设施需求激增，商用液冷泵等核心部件自动化生产需求快速释放。国际贸易格局变化推动全球汽车电子供应链区域化布局深化，具备全球化交付能力、全工艺覆盖与柔性制造解决方案能力的设备厂商迎来全新发展机遇。

报告期内，公司智能制造成套装备业务以核心客户深度合作为根基，加速全球化布局与新兴领域渗透，柔性制造技术优势持续凸显，项目均顺利完成交付验收，为后续业务增长奠定了坚实基础。

在新能源汽车核心零部件与全球化布局方面，公司持续深化头部客户合作，**核心产线批量交付，海外业务实现重要突破**。国内端，公司与博世集团持续深入合作，2025 年顺利交付行车记录仪、域控制器等自动化项目；自研图形化编程多功能工艺岛在联合汽车电子规模化落地，柔性制造效率获客户高度认可。同时，新能源热管理（PTC、空调压缩机、电子水泵/油泵）、线控底盘 One-box ECU 自

自动化生产线均完成交付验收，核心整线交付能力得到充分验证。海外端，2025 年顺利交付匈牙利 Forvia 中控系统 ECU 自动化生产线；2026 年公司将进一步向北美、东南亚等汽车制造集群拓展。

在新兴场景拓展方面，公司以核心工艺能力驱动自动化产线在 AI 服务器液冷、激光雷达等新兴领域持续落地。在 AI 服务器液冷散热赛道，公司为商用液冷泵自动化生产线交付多条产线；在激光雷达领域，持续为禾赛科技交付多条精密激光焊接及检测自动化线体，整合柔性供料系统、6 轴工业机器人及搭载 AI 深度学习算法的 AOI 检测设备，实现激光雷达全流程自动化生产。

（四）固晶键合封装设备：半导体封装设备系列化成型，先进封装 TCB 热压键合设备研发完成

AI 算力爆发成为全球半导体产业最核心的增长引擎。据 WSTS 数据，2025 年全球半导体销售额达 7917 亿美元，同比增长 25.6%；2026 年预计同比增长 26.3% 至 9750 亿美元，2027 年规模有望达到 10706 亿美元。全球封装设备市场在高端 AI 芯片需求的拉动下持续扩容，根据 SEMI 数据，2025 年全球封装设备销售额达 64 亿美元，同比增长 19.6%，已连续三年实现两位数增长；预计 2026 年、2027 年将分别增长 9.2%、6.9%，市场规模依次达到 69.9 亿美元、74.7 亿美元。其中先进封装设备增长尤为突出，在 HBM 堆叠、Chiplet 封装需求爆发的驱动下，2025 年市场规模约 30 亿美元，占整体封装设备市场比重达 46%；预计 2026 年增长 12.8% 至 34 亿美元，2027 年增长 11.5% 至 38 亿美元，增速显著高于行业平均水平，成为 AI 芯片产能扩张的关键支撑。

报告期内，公司持续推进半导体封装设备的研发与产业化，核心产品逐步实现系列化布局，先进封装 TCB 热压键合设备取得重大突破。具体来看：

先进封装设备领域，公司围绕先进封装 TCB 热压键合设备持续开展技术攻关，包括高精度对位系统、超薄芯片顶针机构、高精度 BondHead、分区域共面性调整算法、Flux-less 键合、高速脉冲加热器以及超大尺寸脉冲加热器等技术，设备可适配 HBM 堆叠、CoWoS 封装、CPO 光电共封等前沿场景。据 Yole 预测，2030 年 TCB 热压键合设备市场规模将超 9.36 亿美元。目前，该设备已完成样机开发与多家客户推进打样验证工作。

车载芯片封装设备领域，随着车载和消费电子小信号芯片封装工艺持续迭代升级，公司自主研发的高速高精固晶机性能达到国际领先水平，已在成都先进等

多家国内外头部功率半导体企业实现大批量出货。同时公司紧跟全球产业前沿，正在开发新一代扩散焊接固晶机，精准匹配该领域新一代芯片封装需求。

碳化硅封装设备领域，在新能源储能和 AI 数据中心高效电源需求持续增长的驱动下，碳化硅封装设备需求持续上行。公司自研的碳化硅微纳银（铜）烧结设备，凭借成熟的工艺方案与批量应用案例，成功中标中车时代半导体银烧结设备采购项目，获得市场充分验证。同时，公司多功能固晶机、热贴固晶机技术成熟度持续提升，已与微纳银（铜）烧结设备、甲酸/真空焊接炉、芯片检测 AOI 形成完整的功率半导体封装成套解决方案能力，可为客户提供全流程工艺支持。

2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，快克智能装备股份有限公司董事会 2025 年共召开董事会 6 次，公司在职董事均以现场方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出有效的表决。董事会对股东会会议的执行情况

（二）2025 年度公司共召开了 1 次年度股东会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东会议事规则》的要求，遵照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度内，董事会审计委员会召开会议 5 次，战略委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 2 次。

各委员会依照相关工作细则和议事规则，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会提供专业的参考意见和建议。

（四）投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室负责投资者关系管理工作，协调公司与投资者、监管机构、交易所、政府部门、基金经理、分析师、证券服务机构、媒体之间的信息沟通。通过合法合规、充分严谨的信息披露等多种渠道，增进了投资

者对公司的了解和熟悉，促进了公司与投资者之间的良性互动，强化了尊重并服务投资者的企业文化。公司董事会坚守公司整体利益最大化和股东财富增长的经营理念。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事工作中严格遵守《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关事项发表独立意见。在本年度内，独立董事对历次董事会会议审核的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能制造装备行业。

公司主营业务：精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套装备和固晶键合封装设备，下游主要涉及消费电子、机器人、新能源车、半导体、光通信及光电显示等行业。

1. 光通信行业：AI 算力驱动高速光模块爆发，国产化水平持续提升

2025 年，AI 爆发推动光通信行业进入高速增长期，800G/1.6T 高速光模块成为市场主流，技术迭代与国产化同步加速。全球光模块市场规模同比增长超 65%，800G 产品实现大规模出货，1.6T 产品进入商用初期，国内头部企业在全局高端市场占据主导地位。技术层面，硅光子集成快速渗透，成为高速模块主流方案之一；CPO（共封装光学）作为下一代技术方向，正处于产业化验证与小规模试点阶段。同时，高速光芯片国产化率稳步提升，25G 及以下速率芯片基本实现自主可控，100G 及以上产品逐步突破，核心光电子器件与封装设备国产化进程加快。长期看，AI 算力需求将持续推动光模块向 1.6T、3.2T、6.4T 更高速率演进，行业增长空间广阔。

2. 消费电子行业：AI 终端全面渗透，智能生态加速成熟

2025 年消费电子行业实现智能化重构，AI 终端规模化普及，端云协同生态

成型，直接拉动精密制造与封装设备需求增长。AI 手机全球出货量突破 3.8 亿部、渗透率达 42%，端侧算力升级带动硬件迭代；AIPC 全球出货量 1.78 亿台、渗透率 58%，成为企业端主流采购产品；AI 眼镜全球出货量超 2200 万台，轻量化与光波导技术推动消费级与工业级市场同步爆发；MR 设备全球出货量突破 4800 万台，B 端场景渗透率提升，微显示、空间计算模组需求持续释放。

3. 机器人行业：具身智能落地量产，核心部件国产化提速

2025 年机器人行业在政策、技术与资本驱动下高速发展，工业机器人高端化与人形机器人量产化同步推进，具身智能实现商业化应用。国内工业机器人年产量突破 78 万台，核心部件国产化率显著提升，制造成本持续下探；人形机器人迈入量产阶段，全球市场规模快速扩容，国内企业在关节模组等核心部件实现技术突破；具身智能算法与视觉技术升级，机器人精度与适配性大幅提升，在 3C、汽车电子领域应用持续渗透。

4. 新能源车行业：高压快充与智能驾驶双轮驱动，产业链价值重塑

2025 年新能源车行业技术迭代加速，800V 高压平台全面普及，高阶智驾商业化落地，功率半导体、传感器等核心部件需求激增。L2+级智能驾驶渗透率达 72%，激光雷达、4D 毫米波雷达搭载率大幅提升；800V 及超高压快充成为行业主流，相关车型渗透率超 70%，碳化硅器件应用持续深化；线控底盘等智能底盘部件渗透率与国产化率同步提升，轻量化材料应用进一步普及。

5. 半导体行业：先进封装与第三代半导体发力，国产化进程加快

2025 年半导体行业依托 AI 算力与能源转型双驱动，晶圆产能与先进制程投资持续增长，先进封装成为技术核心方向，异构集成技术推动先进封装市场扩容；AI 算力需求带动 HBM 与硅光技术爆发，AI 芯片国产化稳步推进；第三代半导体在数据中心电源管理及新能源车增长带动下商业化提速，碳化硅功率器件市场高速增长，衬底良率与国产化率提升，氮化镓快充市场规模持续扩张。

（二）发展战略

公司的发展愿景为：致力于为精密电子组装及半导体封装领域提供智能装备解决方案，实现从精密电子组装到半导体先进封装高端装备的跃迁。

● 引领精密焊接技术

公司是国家制造业单项冠军企业，专注精密焊接技术 30 年，形成烙铁焊接、热风焊接、高频焊接、红外焊接、微点焊接、热压焊接、选择性波峰焊、激光焊

接、超声波焊接等系列品类，融合自主研发的运动控制、软件系统、视觉算法、精密模组、工业机器人应用等技术，为客户提供焊接工艺和自动化解决方案。

● 夯实 SMT/PCBA 电子装联和智能制造成套能力

公司开发 3DAOI/SPI、激光打标设备、点胶涂覆设备，形成 SMT/PCBA 电子装联成套设备能力。同时结合精密焊接、机器视觉、软件系统、机器人及自动化集成等优势技术，为 AI 智能硬件、新能源车、医疗电子等领域客户提供智能制造成套解决方案。

● 大力发展光通信和半导体封装成套解决方案能力

公司自主研发先进封装 TCB 热压键合设备、光模块共晶固晶设备、高速高精固晶机、微纳金属烧结设备、真空/甲酸焊接炉、芯片封装 AOI 等，为半导体先进封装、光器件微组装、车规级碳化硅芯片封装提供装备解决方案。

（三） 经营计划

1、持续加大研发投入，加快布局光通信和先进封装高端设备，形成半导体封装成套装备能力

精密焊接和半导体封装固晶键合工艺技术具有相通性，电子装联 SMT 制程和半导体封装制程相融发展，这一技术共性也为公司布局光模块封装设备提供了坚实的技术支撑。在光芯片封装和光模块组装领域，公司正在研发双工位精密共晶系统、在线式多头精密固晶贴装系统、精密贴装可调宽轨道系统等技术；在先进封装高端装备领域，公司针对先进封装 TCB 热压键合设备持续开展技术攻关，包括高精度对位系统、超薄芯片顶针机构、高精度 BondHead、分区域共面性调整算法、Flux-less 键合、高速脉冲加热器以及超大尺寸脉冲加热器等技术。

HB 混合键合设备更加聚焦更微间距的 HBM 芯片封装，而 TCB 热压键合设备可用于 CoWoS 工艺和 HBM 堆叠等整个 AI 芯片的封装环节；混合键合需要搭载更高精度亚微米级的对位系统，可在现有 TCB 热压键合设备对位系统基础上，通过调整光学系统倍率实现。

2、加速国际化布局

公司持续加大海外布局，重点加强海外业务的直接销售和服务能力；在越南、新加坡、马来西亚、泰国、美国、墨西哥、土耳其、波兰等国家构建更加完备的全球化服务网络。



请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案二： 关于 2025 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，快克智能装备股份有限公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2025 年年度报告》全文及其摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案三： 关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）依据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的 2025 年度财务报告；同时依据 2026 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》，具体内容如下：

一、 2025年度财务决算报告
（一） 2025年度主要财务数据和指标
1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	1,080,500,862.14	945,089,608.47	14.33
利润总额	242,083,269.74	234,916,412.68	3.05
归属于上市公司股东的净利润	138,392,244.64	212,200,274.40	-34.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,770,104.78	174,467,392.20	-26.77
经营活动产生的现金流量净额	296,310,411.62	140,645,908.05	110.68
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,411,265,822.91	1,415,561,388.56	-0.30
总资产	2,203,866,001.38	2,013,628,019.71	9.45

2、主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.55	0.85	-35.29
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.85	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.51	0.70	-27.14
加权平均净资产收益率（%）	9.30	15.17	-5.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.59	12.47	-3.88

（二） 财务状况
1、资产和负债状况

单位：元



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	382,574,536.25	17.36	182,150,253.43	9.05	110.03	主要系企业收款增加所致
应收款项融资	37,285,989.39	1.69	16,280,427.98	0.81	129.02	主要系期末未到 A 类票据增加所致
其他应收款	7,737,080.78	0.35	3,698,676.98	0.18	109.19	主要系出口退税所致
使用权资产	10,963,491.64	0.5	2,960,455.13	0.15	270.33	主要系新增租房所致
其他非流动资产	708,564.50	0.03	250,468.77	0.01	182.9	主要系预付设备款增加所致
短期借款	-	0	4,000,000.00	0.2	-100	主要系子公司银行借款到期所致
合同负债	134,497,213.62	6.1	63,742,920.47	3.17	111	主要系报告期内客户支付货款增加所致
应交税费	89,414,354.96	4.06	25,028,799.05	1.24	257.25	主要系补缴 2024 年度及以前企业所得税所致
其他应付款	70,329,900.09	3.19	1,048,395.76	0.05	6608.34	主要系报告期

						内 实 施 股 权 激 励 计 划 产 生 的 回 购 义 务 所 致
一年内到期的非流动负债	2,976,356.86	0.13	1,668,345.78	0.08	78.4	主 要 系 新 增 租 赁 厂 房 所 致
其他流动负债	17,914,642.24	0.81	13,165,092.81	0.65	36.08	主 要 系 报 告 期 内 客 户 支 付 的 增 加 所 致
租赁负债	8,123,827.17	0.37	1,063,876.18	0.05	663.61	主 要 系 新 增 租 赁 厂 房 所 致

2、经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,080,500,862.14	945,089,608.47	14.33
营业成本	565,410,900.09	486,054,863.64	16.33
销售费用	85,086,851.48	79,653,964.21	6.82
管理费用	52,078,293.33	42,486,046.24	22.58
财务费用	-1,010,458.96	-5,066,125.38	80.05
研发费用	139,475,453.43	132,809,261.00	5.02

注：

1) 营业收入变动原因说明：2025 年度内营业收入稳健增长，主要系公司积极把握 AI 产业发展带来的数据中心、半导体等行业机会，持续践行技术创新和全球化大客户战略，机器视觉 AOI 持续增长，半导体固晶键合设备步入量产。

2) 营业成本变动原因说明：主要系匹配收入，无较大变动。

3) 销售费用变动原因说明：2025 年度内无较大变动。

4) 管理费用变动原因说明：主要系 2025 年度内薪酬福利、股份支付费用等增加所致。

5) 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动所致。

6) 研发费用变动原因说明：2025 年度内无较大变动。

3、现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	296,310,411.62	140,645,908.05	110.68
投资活动产生的现金流量净额	18,880,803.83	75,474,385.02	-74.98
筹资活动产生的现金流量净额	-108,226,629.88	-189,324,117.98	42.84

注：

1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2025 年度内收款增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资理财赎回增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2025 年度内收到股权激励计划的出资款所致。

二、 2026年度财务预算报告

(一) 预算编制说明

公司根据 2026 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，同时考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了本预算报告。

本预算编制的基本假设前提是：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

(二) 主要预算指标及措施

2026 年度，公司将紧紧围绕为精密电子组装及半导体封装领域提供智能装备解决方案的发展规划，加强技术、产品的创新研发；深耕客户需求，优化营销策略；持续完善激励考核机制，加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，力保实现经营业绩增长目标。

（三） 特别提示

本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案四： 关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，拟对年度利润进行分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 783,420,376.86 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 253,661,118 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,830,559.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 91.65%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积转增 0.30 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 253,661,118 股，以此计算本次送转股后，公司的总股本为 329,759,453 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-005）。如在上述公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案五： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备相关业务审计从业资格，在公司 2025 年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构；本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案六： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》即将到期，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。决议自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案七： 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司薪酬管理办法》等有关规定，快克智能装备股份有限公司确认了公司董事 2025 年度薪酬，具体情况如下：

1、在公司担任其他职务的董事

序号	姓名	2025 年度薪酬（万元）
1	戚国强	85.13
2	窦小明	72.94
3	刘志宏	85.13

2、不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事

董事长金春女士不在公司领取薪酬。

3、独立董事津贴

序号	姓名	2025 年度薪酬（万元）
1	秦志军	2.92
2	万文山	5.00
3	王亚明（已离职）	2.08

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案八： 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，促进公司高质量可持续发展，保障全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，快克智能装备股份有限公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案九： 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-010）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案十： 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中，1 人因个人原因离职不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,000 股进行回购注销。根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次因激励对象离职而回购注销的价格为 7.88 元/股。公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次拟用于回购的资金总额为 102,440 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案十一：关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

（一）注册资本增加

1、公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向 21 名激励对象授予 204,000 股限制性股票。

因此，上述限制性股票登记完成后，公司股份总数共计增加 204,000 股，注册资本共计增加 204,000 元；公司注册资本将由人民币 253,661,118 元变更为 253,865,118 元，公司的股份总数将由 253,661,118 股变更为 253,865,118 股。

2、公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的股本为基数，向股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。

因此，本次利润分配及公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由 253,865,118 股变更为 330,024,653 股，公司注册资本由人民币 253,865,118 元变更为人民币 330,024,653 元。上述总股本以及注册资本的变更以 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》为前提。

（二）注册资本减少

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 13,000 股。

因此，上述回购注销完成后，公司股份总数共计减少 13,000 股，注册资本共计减少 13,000 元；公司注册资本将由人民币 330,024,653 元变更为 330,011,653 元，公司的股份总数将由 330,024,653 股变更为 330,011,653 股。

综上，公司注册资本将由人民币 253,661,118 元变更为 330,011,653 元，公司的股份总数将由 253,661,118 股变更为 330,011,653 股。上述事项涉及修订《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币 253,661,118 元。	第五条 公司注册资本为人民币 330,011,653 元。
2	第二十条 公司股份总数为 253,661,118 股，全部为人民币普通股	第二十条 公司股份总数为 330,011,653 股，全部为人民币普通股

注：本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）及相关制度全文。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案十二：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2025 年的工作中，秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法規的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职情况报告》（王亚明、万文山、秦志军）。

以上述职报告，请各位股东及股东代表听取。

快克智能装备股份有限公司董事会
2026 年 5 月